

|| 企業調査レポート ||

フェローテックホールディングス

6890 東証スタンダード市場

[企業情報はこちら >>>](#)

2022年12月28日(水)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

目次

■ 要約	01
1. 2023年3月期第2四半期の業績概要	01
2. 2023年3月期の業績見通し	01
3. 新たに2025年3月期の目標を設定	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 事業セグメント	03
3. 特色、強み	03
■ 業績動向	04
1. 2023年3月期第2四半期の業績概要	04
2. セグメント別概況	06
3. 主な設備投資	07
■ 今後の見通し	08
1. 2023年3月期業績見通し	08
2. 主要製品の現況と見通し	08
■ 中期経営計画と重点施策	09
1. 中期経営計画の進捗	09
2. 今後の重点施策	09
■ 株主還元策	10

■ 要約

2023年3月期第2四半期の売上高・営業利益は、 いずれも第2四半期として過去最高業績を更新

フェローテックホールディングス<6890>の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC(化学蒸着法炭化ケイ素)製品、磁性流体、サーモモジュールなどの様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄サービスやシリコンウエーハの研磨なども行う企業である。

1. 2023年3月期第2四半期の業績概要

2023年3月期第2四半期決算は、売上高が前年同期比63.0%増の97,505百万円、営業利益が同59.3%増の17,061百万円、経常利益が同88.9%増の23,554百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同7.4%減の15,979百万円となり、売上高及び営業利益はいずれも第2四半期としては過去最高となった。事業別では、世界的な半導体不足を背景とした半導体製造装置メーカー及びデバイスメーカーからの旺盛な需要に支えられて、半導体等装置関連の売上高は63,791百万円(前年同期比62.8%増)、セグメント利益は11,707百万円(同64.5%増)となった。各製品とも順調に拡大したが、特にシリコンパーツの伸びが著しかった。また電子デバイスでも、パワー半導体用基板が大きく寄与して売上高は23,073百万円(同88.9%増)、セグメント利益は5,325百万円(同74.5%増)となった。さらに営業外において、為替差益5,198百万円の計上(前年同期は1,503百万円)があり、経常利益の伸びはさらに大きくなった。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に持分変動利益9,327百万円を特別利益として計上したことなどから、減益となった。

2. 2023年3月期の業績見通し

2023年3月期通期の業績は、現時点で売上高200,000百万円(前期比49.5%増)、営業利益34,000百万円(同50.4%増)、経常利益39,000百万円(同50.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益24,000百万円(同10.0%減)の予想としており、前回予想(2022年8月に発表した売上高195,000百万円、営業利益32,500百万円)から再度上方修正された。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要も引き続き強含みで推移すると予想され、この予想が達成される可能性は高いだろう。むしろ、さらなる上積みがあるのかが焦点になると思われる。通期での設備投資額は73,622百万円程度(前期は35,378百万円)、減価償却費は13,081百万円(同8,085百万円)と計画している。

要約

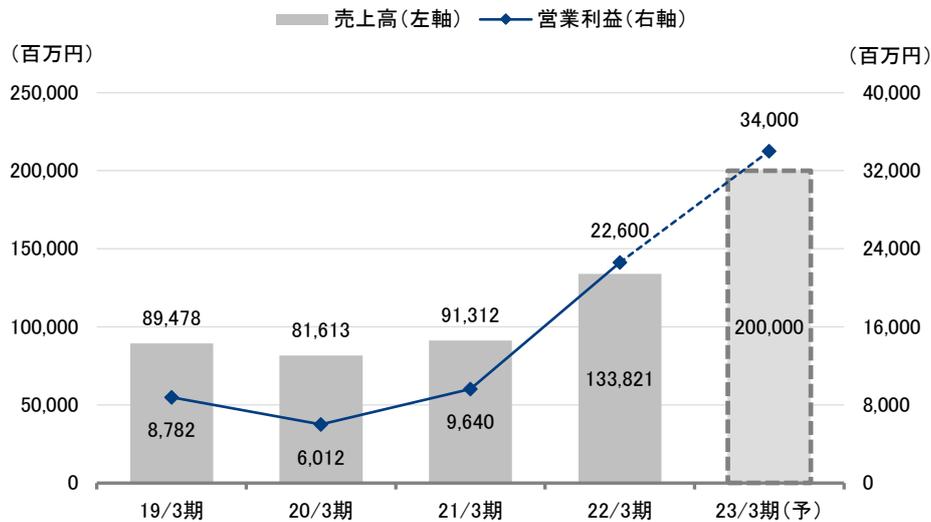
3. 新たに2025年3月期の目標を設定

同社は、2024年3月期に売上高2,300億円、営業利益400億円（営業利益率17.4%）とする中期経営計画を発表した。2023年3月期の目標は当初売上高1,250億円、営業利益190億円（同15.2%）としていたが、2022年11月に売上高2,000億円、営業利益340億円（同17.0%）と2回目の上方修正を発表した。2024年3月期の目標値に変更はないが、旺盛な需要を踏まえ、新たに2025年3月期の目標値（計画値ではない）として売上高2,900億円、営業利益520億円を発表した。今後の事業展開によって目標値の変更あるいは新計画の発表が行われる可能性が高い。また今後の重点施策として、1) 生産拠点のグローバル化、2) 生産現場での「デジタル化・自動化・見える化」、3) 事業ポートフォリオの強化（非半導体製造装置分野の事業拡大）、を掲げている。

Key Points

- ・石英、セラミックス等の無機系製品の大手メーカー。半導体業界向けが多い
- ・2023年3月期第2四半期は予想を大幅に上回って着地。通期予想も上方修正
- ・中期経営計画目標値を前倒しで達成済み

業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

■ 会社概要

主要顧客は大手半導体デバイス及び同製造装置メーカー

1. 会社概要

同社は2022年3月末時点で傘下に連結子会社55社、持分法適用子会社9社を擁する純粋持株会社である。元々は1980年に米国Ferrofluidics Corporation（現Ferrotec（USA）Corporation）の日本法人「日本フェローフリュイディクス株式会社」として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、磁性流体、サーモモジュールなど主に無機材料を使った様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。

2. 事業セグメント

前述のように同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時にM&Aによって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたっている。事業セグメントは、半導体等装置関連（2022年3月期の売上比61.4%）、電子デバイス（同20.2%）、その他（同18.4%）の3つに分けられており、それぞれサブセグメントが置かれている。

3. 特色、強み

(1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド（SiC）など幅広い無機系素材の生成・加工などに長年携わってきた。そのため、社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ（素材の性質、生成方法、加工方法等）が蓄積されており、これが同社の特色かつ強みと言えるだろう。

(2) 製造装置も手掛ける

同社は、単に素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対し、素材・加工部品・最終製品・製造装置など様々な提案（ソリューションの提供）を行うことができる。

(3) ワンストップソリューションが可能

同社は、半導体製造装置内の部品の洗浄（取り外し・洗浄・据付）や製造装置の組立等のサービス事業も展開している。顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで外注化（アウトソーシング）することが可能であり、これも同社の強みと言える。

会社概要

(4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、同社の主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーも多い。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたり製品や部品を供給しており、これら顧客との深い信頼関係も同社の財産であり強みとなっている。

業績動向

2023年3月期第2四半期は世界的な半導体需要増を背景に大幅増益

1. 2023年3月期第2四半期の業績概要

(1) 損益状況

2023年3月期第2四半期決算は、売上高が前年同期比63.0%増の97,505百万円、営業利益が同59.3%増の17,061百万円、経常利益が同88.9%増の23,554百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同7.4%減の15,979百万円となり、売上高及び営業利益はいずれも第2四半期としては過去最高となった。

事業別では、世界的な半導体不足を背景とした半導体製造装置メーカー及びデバイスメーカーからの旺盛な需要に支えられて、半導体等装置関連の売上高は63,791百万円（前年同期比62.8%増）、セグメント利益は11,707百万円（同64.5%増）と大幅増収増益となった。各製品とも順調に拡大したが、特にシリコンパーツの伸びが著しかった。また電子デバイスでも、パワー半導体用基板が大きく寄与して売上高は23,073百万円（同88.9%増）、セグメント利益は5,325百万円（同74.5%増）となった。

さらに営業外において、為替差益5,198百万円の計上（前年同期は1,503百万円）があり、経常利益の伸びはさらに大きくなった。一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に持分変動利益9,327百万円を特別利益として計上したことなどから、減益となった。

2023年3月期第2四半期業績

(単位：百万円)

	22/3期2Q		23/3期2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	59,826	100.0%	97,505	100.0%	37,679	63.0%
売上総利益	22,238	37.2%	34,538	35.4%	12,300	55.3%
販管費	11,530	19.3%	17,476	17.9%	5,946	51.6%
営業利益	10,708	17.9%	17,061	17.5%	6,353	59.3%
経常利益	12,468	20.8%	23,554	24.2%	11,086	88.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	17,257	28.9%	15,979	16.4%	-1,278	-7.4%
設備投資額	13,898	23.2%	24,928	25.6%	11,030	79.4%
減価償却費	3,820	6.4%	5,596	5.7%	1,776	46.5%

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

設備投資により有形固定資産が増加

(2) 財務状況

2023年3月期第2四半期末の財務状況は、流動資産が190,942百万円（前期末比57,528百万円増）となった。主に現金及び預金の増加31,246百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加16,482百万円、たな卸資産の増加14,119百万円による。現金及び預金が増大となったのは、主に中国子会社の第三者割当増資による増加（19,759百万円）である。固定資産は前期末比で48,032百万円増加し179,390百万円となった。主にマテリアル製品（石英、セラミックス、シリコンパーツ）、パワー半導体用基板等の増産投資を実施したことによる有形固定資産の増加38,533百万円、無形固定資産の増加3,856百万円（主に新規連結子会社による「のれん」の増加3,144百万円）、投資その他資産の増加5,644百万円（主に中国子会社によるSiCパワーデバイスメーカーである蕪湖啓迪半導体有限公司への出資4,076百万円など）による。その結果、資産合計は370,333百万円（同105,561百万円増）となった。

負債合計は、145,306百万円（同41,491百万円増）となった。要因として、電子記録債務を含む支払手形及び買掛金の増加6,973百万円、1年内償還予定の社債と1年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金等の増加12,104百万円、社債の減少3,724百万円、転換社債型新株予約権付社債の減少2,134百万円、長期借入金の増加12,851百万円等による。また純資産合計は、225,026百万円（同64,069百万円増）となった。中国子会社の第三者割当増資による資本剰余金の増加11,034百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加14,958百万円、円安進行に伴う為替換算調整勘定の増加17,334百万円、中国子会社への第三者割当増資による非支配株主持分の増加19,762百万円等によるものである。この結果、2023年3月期第2四半期末の自己資本比率は47.3%（前期末は49.5%）となった。

(3) 新規連結子会社

2023年3月期第2四半期中に、以下の会社が新規連結子会社となった。

1) 東洋刃物（株）

- ・1925（大正14）年創業の工業用機械刃物製造分野で国内トップを走る工業用刃物の老舗企業
- ・TOBを実施し、2022年7月より完全子会社化（連結セグメントは「その他」事業）
- ・杭州で展開する刃物事業とのシナジーを創出するため、同敷地内に生産拠点を構築し、技術・人材を融合させる
- ・今後情報産業分野等で中国市場の開拓を図る
- ・2023年3月期での売上寄与見込みは4,023百万円

2) (株) 大泉製作所

- ・温度センサの有力メーカー
- ・TOBを実施し、2022年8月より子会社化（連結セグメントは「電子デバイス」事業）
- ・大泉製作所が得意とする車載・空調用の温度センサ技術に同社が培った自動化・デジタル化の生産技術力を融合させ、日本・中国・欧州市場での販売拡大を図る
- ・温度センサの日本・中国での生産能力増強を検討
- ・2023年3月期での売上寄与見込みは9,896百万円

フェローテックホールディングス | 2022年12月28日(水)
6890 東証スタンダード市場 | <https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

2. セグメント別概況

セグメント別では、主力の半導体等装置関連は売上高 63,791 百万円（前年同期比 62.8% 増）、営業利益 11,707 百万円（同 64.5% 増）、電子デバイスは売上高 23,073 百万円（同 88.9% 増）、営業利益 5,325 百万円（同 74.5% 増）、その他は売上高 10,640 百万円（同 26.2% 増）、営業利益 398 百万円（同 39.7% 減）となった。

セグメント別売上高・営業利益

（単位：百万円）

	22/3 期 2Q		23/3 期 2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	59,826	100.0%	97,505	100.0%	37,679	63.0%
半導体等装置関連	39,178	65.5%	63,791	65.4%	24,613	62.8%
真空シール・金属加工	8,228	13.8%	12,833	13.2%	4,605	56.0%
石英製品	10,132	16.9%	13,983	14.3%	3,851	38.0%
シリコンパーツ	2,778	4.6%	9,325	9.6%	6,547	235.7%
セラミックス	8,422	14.1%	13,030	13.4%	4,608	54.7%
CVD-SiC	1,389	2.3%	1,962	2.0%	573	41.3%
EB ガン・LED 蒸着装置	3,129	5.2%	3,907	4.0%	778	24.9%
再生ウエーハ	-	-	652	0.7%	652	-
装置部品洗浄	4,483	7.5%	5,939	6.1%	1,456	32.5%
石英坩堝	574	1.0%	2,075	2.1%	1,501	261.6%
電子デバイス	12,213	20.4%	23,073	23.7%	10,860	88.9%
サーモモジュール	8,424	14.1%	11,546	11.8%	3,122	37.1%
パワー半導体用基板	3,349	5.6%	7,919	8.1%	4,570	136.5%
磁性流体・その他	440	0.7%	485	0.5%	45	10.2%
センサ（大泉製作所）	-	-	3,123	3.2%	3,123	-
その他	8,434	14.1%	10,640	10.9%	2,206	26.2%
営業利益	10,708	17.9%	17,061	17.5%	6,353	59.3%
半導体等装置関連	7,118	18.2%	11,707	18.4%	4,589	64.5%
電子デバイス	3,052	25.0%	5,325	23.1%	2,273	74.5%
その他	660	7.8%	398	3.7%	-262	-39.7%
調整額	-123	-	-369	-	-246	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

(1) 真空シール・金属加工

売上高は 12,833 百万円（前年同期比 56.0% 増）となった。半導体製造装置メーカーの金属加工需要を積極的に取り込み、増強した常山工場等が稼働したことで大幅増収となった。

(2) 石英製品

売上高は 13,983 百万円（前年同期比 38.0% 増）となった。需要の拡大に加えて常山工場・東台工場の稼働により増収となった。

業績動向

(3) シリコンパーツ

売上高は9,325百万円(前年同期比235.7%増)となった。需要拡大に対して銀川工場の生産能力が拡大したことで増収となった。需要の要因は、半導体業界全体が活況であったことのほか、米国系大手半導体製造装置メーカーがそれまで内製化していた部品を同社製品に切り替えたことも、売上高を押し上げる要因となった。同社製品が高く評価されてきた証と言える。

(4) セラミックス

売上高は13,030百万円(前年同期比54.7%増)となった。半導体向け製品及びプローブカード向け製品の需要が増加し、大幅増収となった。杭州工場の増強も寄与した。

(5) CVD-SiC

売上高は1,962百万円(前年同期比41.3%増)となった。半導体向け需要増に対して、岡山工場での増産が寄与した。

(6) 再生ウエーハ

再生ウエーハの銅陵工場が稼働開始し、売上高は652百万円(前年同期は売上なし)となった。

(7) 装置部品洗浄

中国における半導体メーカー・FPDメーカーの洗浄需要増加を取り込み、売上高は5,939百万円(前年同期比32.5%増)となった。

(8) サーモモジュール

売上高は11,546百万円(前年同期比37.1%増)となった。5G通信機器向け及びPCR検査機など医療分野向けが堅調に推移し、自動車温調シート向けの減少をカバーした。

(9) パワー半導体用基板

売上高は7,919百万円(前年同期比136.5%増)となった。特に、自動車・EV等向けのAMB(Active Metal Brazing)基板売上が急伸した。DCB(Direct Copper Bonding)基板も生産能力の増強が寄与し、売上は拡大した。研究院の機能強化が奏功し高耐熱・高強度のDPC(Direct Plated Copper)基板も展開した。さらなる製品開発を推進している。

3. 主な設備投資

設備投資額(キャッシュ・フローベース)は、24,928百万円(前年同期は13,898百万円)となった。主に中国の銅陵再生ウエーハ事業、上海中国本社、広州洗浄事業、常山真空シール・金属加工事業の子会社における設備投資である。減価償却費は5,596百万円(同3,820百万円)となった。

■ 今後の見通し

2023年3月期営業利益は上方修正され340億円予想。 半導体等装置関連、電子デバイスともに堅調

1. 2023年3月期業績見通し

2023年3月期通期の業績は、売上高200,000百万円(前期比49.5%増)、営業利益34,000百万円(同50.4%増)、経常利益39,000百万円(同50.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益24,000百万円(同10.0%減)と予想しており、前回予想(2022年8月発表の売上高195,000百万円、営業利益32,500百万円)から上方修正した。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要も引き続き強みで推移すると予想され、この予想が達成される可能性は高いだろう。むしろ、さらなる上積みがあるのかが焦点になると思われる。通期での設備投資額は73,622百万円(前期は35,378百万円)、減価償却費は13,081百万円(同8,085百万円)を計画している。

セグメント別売上高は、半導体等装置関連127,266百万円(前期比55.0%増)、電子デバイス53,061百万円(同96.4%増)、その他19,673百万円(同20.3%減)を予想している。

2. 主要製品の現況と見通し

(1) 真空シール・金属加工

半導体製造装置メーカーの金属加工需要を取り込み、常山工場の第二期が竣工していることから、売上高は前期比91.9%増の26,345百万円を予想している。

(2) 半導体材料(石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)

石英製品は需要が底堅く推移する見込みで、常山工場・東台工場の稼働により売上は伸長する見通し。売上高は前期比30.4%増の27,676百万円を見込む。シリコンパーツは需要拡大が著しく、銀川工場の増強が奏功し急速に売上が拡大する見通しで売上高は前期比107.8%増の17,799百万円が見込まれる。セラミックスも半導体関連メーカーの需要拡大が継続、プローブカードメーカー向けも堅調に推移する見込みで、売上高は前期比39.2%増の26,184百万円と予想している。CVD-SiCも半導体関連メーカーの需要拡大に伴い、岡山工場の増産が寄与して売上高は前期比33.0%増の3,958百万円が見込まれている。

(3) 装置部品洗浄

売上高は前期比17.7%増の11,386百万円を見込む。中国における半導体関連の洗浄需要は堅調に拡大する見込みで、これに伴い工場新設やサービス分野の拡大を進めており、売上伸長が継続する見通し。

(4) サーモモジュール

売上高は前期比21.3%増の21,390百万円の見込み。引き続き5G通信機器向け・医療分野ともに需要は堅調に推移する見通しとなっている。

今後の見通し

(5) パワー半導体用基板

売上高は前期比 146.1% 増の 20,849 百万円を予想している。自動車・EV（電気自動車）等向けの AMB 基板需要が増加するなか、能力拡大が奏功し、売上が続伸する見込み。DCB 基板も好調を継続する見込みで、DPC 基板等の製品レンジ拡大も推進している。

■ 中期経営計画と重点施策

当初の中期経営計画は達成済み、 新たな目標として 2025 年 3 月期に営業利益 520 億円を掲げる

1. 中期経営計画の進捗

(1) 数値目標

同社は、2024 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を発表している。この中期経営計画の当初の定量的目標は、2023 年 3 月期に売上高 1,250 億円、営業利益 190 億円、さらに最終年度となる 2024 年 3 月期は売上高 1,500 億円、営業利益 250 億円が目標であった。しかし既に 2022 年 3 月期に売上高 1,338 億円、営業利益 226 億円を達成したため、現時点では修正計画値として 2023 年 3 月期に売上高 2,000 億円、営業利益 340 億円、2024 年 3 月期に売上高 2,300 億円、営業利益 400 億円、ROE15% 超、自己資本比率 40% 超を掲げている。さらに旺盛な市場環境を受けて当初計画が 1 年以上前倒しで達成されたことから、新たに 2025 年 3 月期の目標値（計画値ではない）として売上高 2,900 億円、営業利益 520 億円を発表した。

(2) 設備投資

設備投資計画については、2024 年 3 月期までの 3 年間で 1,800 億円の設備投資をすると発表していたが、現時点でこの計画に変更はないようだ。既に 2022 年 3 月期に 354 億円の投資を行っていることから、2023 年 3 月期は 736 億円、2024 年 3 月期は 710 億円の投資を行う計画となっている。

この 1,800 億円の投資については、短期・中期で約 1,200 億円を計画している。主に半導体分野、電子デバイス等を中心に市場拡大の機会を捉え、生産力増強へ積極的に投資する。その一方で、長期的な収益に貢献する「長期的な投資」に約 600 億円を計画している。主に 1) 半導体分野の製品レンジ拡充、2) EV、新エネルギー車関連、3) 新たな柱となる事業への投資、4) 事業連関性や潜在的成長力等に照らした M&A などに投資する計画だ。M&A の投資額は投資機会により変動するが、3 年以内に ROIC を 5% 以上とすることができる M&A を検討する予定だ。これらの方針は変わっていない。

2. 今後の重点施策

同社では、中期経営計画の推進と合わせて、今後の重点施策として、1) 生産拠点のグローバル化、2) 生産現場での「デジタル化・自動化・見える化」、3) 事業ポートフォリオの強化（非半導体製造装置分野の事業拡大）を掲げている。

中期経営計画と重点施策

(1) 生産拠点のグローバル化

これまでの同社は、中国を中心に事業を積極的に展開してきたが、米中経済摩擦や地政学的リスクを考慮し、生産拠点のグローバル化を図る。

1) マレーシア

2022年4月に設立したマレーシアのケダ州クリム・ハイテクパーク内（ペナン島近隣）の製造子会社 Ferrotec Manufacturing Malaysia に新工場を建設中である。2023年7月竣工予定で、東南アジア顧客に密着した事業展開（石英製品・セラミックス・金属加工/組立等）を図る。

2) 日本（石川県）

中長期での需要拡大が見込まれる半導体製造装置関連部材「ファインセラミックス」「マシナブルセラミックス」の増産を石川エリアで対応している。2022年11月に第2工場が竣工、第3工場も用地を確保済で2023年夏頃には着工予定である。

3) 日本（熊本県）

「シリコンアイランド」九州の熊本県大津町に生産拠点を新設予定（2023年春先以降を目途に着工、2024年6月竣工を予定）している。現在、新拠点で事業展開する半導体関連製品、サービスを検討している。

(2) 「デジタル化・自動化・見える化」の水平展開

中国の生産拠点でERP、MESをはじめ、様々なシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現（例：AI活用、ロボットの積極導入）した。今後は、日本やマレーシアの新拠点でもこれらの自動化投資（水平展開）を積極的に進める。

(3) 非半導体製造装置分野における事業拡大

電子デバイス事業では、従来から多業界で採用が拡大する温調デバイス「サーモモジュール」に加えて、世界的な省エネ化トレンドに沿った「パワー半導体用絶縁基板」が大きな事業の柱に成長しており、今後も注力する。また新たに連結子会社に加わった下記2社も中期的に事業拡大を目指し、非半導体製造装置の比率を高める。

- ・大泉製作所：温度センサは車載・空調、サーミスタ（素子）は光通信分野などに注力
- ・東洋刃物：工業用刃物は情報産業分野などを中心に、国内・中国の市場開拓を強化する

株主還元策

当面は積極的な設備投資優先も、将来はさらなる増配に期待

同社は株主還元策として配当を実施している。2019年3月期、2020年3月期と年間24円配当を行ったが、2021年3月期は記念配当を含めて30円の配当を行い、2022年3月期は50円の配当を行った。2023年3月期は、好調な業績に伴い年間100円（中間50円、期末50円）を発表している。同社は「今後は、投資拡大のため配当性向は下がるものの、収益性改善に応じた安定配当による最大限の株主還元を目指す」と述べており、利益水準によってはさらなる増配の可能性もありそうだ。

重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受けて作成されていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp